

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 电话会议
参与单位名称	国金证券；西部证券；华源证券；群益证券；国盛证券；中信建投证券；东方证券资管；华泰证券；东方证券；中信证券；光大证券；东北证券；东方财富证券；华西证券；国都证券；国投证券；天风证券；招商证券；广发证券；美银证券；中泰证券；华福证券自营；交银证券；中国银河证券；兴业证券；国泰海通证券；开源证券；长江证券；山西证券；华安证券；国海证券；平安证券；国联民生证券；麦高证券；Point72 HongKong；宁远资本；Harding Loevner；Schonfeld；工银安盛资管；朱雀基金；华宝基金；易方达基金；兴证国际；同泰基金；西部利得基金；碧云资管；Willing Capital；天治基金；浩成资管；圆信永丰基金；鹏华基金；金之灝基金；摩根士丹利亚亚洲等 95 家机构及相关人员。
时间	2026 年 8 月 19 日 21:00-22:10
地点	线上电话会议、公司会议室。
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 段晓婷女士 董事会秘书 乔端先生

投资者关系 活动主要内容介绍	武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在激光精密微纳加工领域深耕多年，主营业务为激光精密微纳加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，目前下游应用领域主要覆盖全应用场景下的光伏行业，正在积极研发半导体、新型显示等领域的激光加工设备。 公司以激光精密微纳加工技术为核心，瞄准数据新基建带来的广阔市场机遇，以智能制造装备为主业，构建“光伏主营业务为基础、半导体业务为延伸、持续布局前瞻技术与产品、配套服务为支撑”的持续发展的业务体系。在光伏领域，公司聚焦光伏电池及组件全流程激光加工需求，覆盖BC、TOPCon、HJT、钙钛矿、叠层电池及组件封装互联等技术路线，是光伏电池及组件核心设备供应商之一，长期服务于行业头部客户，并与客户围绕新技术、新工艺落地及降本增效需求开展深度协同。 在半导体方向，公司依托超快激光、精密光学、微纳加工、运动控制及自动化系统集成等方面的技术积累，积极拓展先进封装、新型显示/光源、化合物半导体等泛半导体应用场景。公司重点布局的TGV激光微孔设备主要面向先进封装领域中玻璃基板通孔、微孔及微槽加工需求，同时也拓展至FAU及光通信玻璃无源器件等应用场景。公司围绕PCB超快激光钻孔、Micro LED显示光源、化合物半导体等方向持续开展激光加工设备研发与客户验证工作。报告期内，相关业务仍处于产业导入和市场拓展阶段。未来公司将继续围绕AI算力、高性能计算、先进封装、新型光源等领域的工艺升级需求，推进相关产品研发、客户验证和商业化落地。 公司在武汉、无锡、新加坡、以色列设有研发中心，在武汉、无锡和新加坡具备生产能力，形成了较为完善的国际化研发体系和产业布局。 一、经营方面 2026年上半年，公司实现营业收入10.29亿元，同比下降12.02%；
---------------------------	--

实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比下降6.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.71亿元，同比下降14.16%。

报告期内，公司收入和扣非净利润同比有所下降，主要与光伏行业阶段性波动、客户资本开支节奏、设备交付及收入确认节奏等因素有关，季度间收入确认存在一定波动。

研发投入方面，2026年上半年，公司研发投入为1.12亿元，占营业收入比例为10.88%，较去年同期的10.31%有所提升。公司将继续坚持技术创新驱动，围绕光伏高效电池及组件技术路线、半导体先进封装、先进显示、光源等方向开展研发工作，保持较高研发强度，优先保障新技术、新工艺和新产品研发，不断增强产品竞争力。

现金流方面，2026年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，上年同期为-1.43亿元，同比改善明显。主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

资产负债结构方面，截至2026年6月30日，公司总资产为68.60亿元，较上年末增长3.12%；归属于上市公司股东的净资产为49.34亿元，较上年末增长25.92%；资产负债率为28.08%，较上年末41.10%明显下降，主要系公司可转换公司债券转股及剩余未转股部分完成提前赎回，债务规模显著下降，资本结构进一步优化。截至报告期末，公司可转换公司债券已全部转股或赎回。

二、投资者互动主要内容

1.公司TGV业务目前的应用场景和产业化节奏如何？

答：TGV相关应用目前主要包括先进封装玻璃基板通孔、FAU及光通信玻璃无源器件等方向。玻璃基板在表面平整度、热膨胀匹配和高频信号传输等方面具备优势，未来有望在先进封装、RDL、CPO、新型显示、射频器件和功率器件等领域应用。

从产业进展看，公司TGV设备已覆盖晶圆级和面板级应用，并持续与不同区域、不同类型客户开展合作。玻璃基板方向已有客户复购需求。总体来看，TGV及其衍生应用仍处于产业导入阶段，但客户关注度和市场活跃度较高。

2.公司TGV设备的技术特点、产品体系及后续拓展方向是什么？

答：公司TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质、不同厚度玻璃基板及相关玻璃材料的微孔、微槽加工，提升基板电气性能和热性能，并为后续金属化工艺提供条件。该设备对加工精度、孔径质量、崩边控制、热影响控制、加工效率及后道工艺适配性要求较高。

从产品体系看，公司在TGV方向除激光改质设备外，也在布局刻蚀、AOI检测等配套设备。其中，激光改质设备持续取得订单和收入，激光改质设备与刻蚀设备已开始出现成套订单，AOI检测设备正在积极验证。未来，公司将根据客户工艺路线、孔型设计、基板尺寸、产能要求等因素，灵活提供单机或配套设备方案，持续丰富TGV产品矩阵。

3.当前TGV产业化过程中主要瓶颈在哪里？是否会影响公司设备导入？

答：根据与客户沟通，公司TGV激光改质技术能够满足客户在良率和技术指标方面的相关需求。当前玻璃基板产业化的主要难点更多来自后续金属化、膜层及材料复合的工艺良率和微裂纹等问题。行业内相关客户、材料厂商和设备厂商正在共同推进解决方案。

4.公司PCB超快激光精密加工设备进展如何？

答：针对PCB电子级树脂基新型功能复合材料在高速、高频、高算力应用场景下的精密加工需求，公司依托超快激光技术积累，推进PCB超快激光精密加工设备研发。公司重点关注更小孔径、更高密度、更高孔质量及复杂材料加工需求，主要方向包括高端PCB、载板、M9

材料、陶瓷材料及部分特定类型PCB等应用。

目前，公司与十家以上行业客户保持持续沟通，并开展打样验证工作。由于相关应用多属于新材料、新结构和新工艺方向，量产导入节奏取决于客户验证、产品定义、工艺成熟度及市场拓展进展，仍存在一定不确定性。

5.公司光伏组件设备业务进展如何？LIB和MBI技术分别有什么特点？

答：2026年上半年，公司在光伏组件设备方面取得订单突破。该业务是公司围绕光伏主业向组件封装及互联环节延伸的重要方向。目前公司已形成并向客户推广的技术主要包括LIB激光整版焊接技术和MBI导电背板互联技术。

LIB技术主要面向光伏组件创新封装工艺，是以激光作为核心热源的整版焊接技术。相较传统串焊或局部焊接方式，LIB技术可在组件封装环节一次性完成整版金属化焊接，通过激光能量精准控制实现焊带、电极及焊点之间的稳定连接。该技术具备非接触、热影响区域可控、控温精度高、机械张力小、焊接一致性高、材料损耗低等特点，可降低电池片隐裂、微裂纹风险，提高焊点拉力均匀性和组件长期可靠性，并兼容多种电池及组件结构。

MBI技术主要面向BC分布式高效光伏组件，是一种基于金属背板的组件互联方案。该技术通过带绝缘层的导电金属背板作为电流汇流与电池片互联载体，使BC电池背面电极与金属背板实现直接导通，从而替代或减少传统焊带互联方式。MBI技术具备接触电阻低、电流传输路径优化、散热能力强、减少焊带应力微裂纹、降低银浆和铜材单耗等优势，适配多种BC电池结构和组件设计。

6.公司如何看待BC技术路线及相关设备需求？

答：BC技术路线凭借较高转换效率和较优组件表现，市场认可度持续提升，渗透率仍持续提升。公司预计2026年BC新增及改扩产需求

	约为40-50GW。 公司在BC方向布局激光微刻蚀、电镀图形化等关键工艺，并在BC组件端布局MBI等互联技术。随着BC产能持续增长、技术路线逐步成熟及组件端工艺升级需求提升，公司相关设备有望受益于BC产业化推进。公司将持续与头部客户合作，通过降低设备投入、提升良率、降低生产成本，推动BC电池及组件的规模化和产业化。 7. TOPCon升级改造公司有哪些技术布局？ 答：在TOPCon方向，公司围绕提质增效需求布局TCP、TCI、激光诱导烧结以及激光二次烧结等技术和设备。相关设备服务于TOPCon产线效率提升、工艺优化及存量产线改造需求。受行业产能利用率、客户投资节奏及政策要求等因素影响，TOPCon相关改造需求节奏存在一定波动。 在钙钛矿及叠层方向，公司围绕大尺寸玻璃衬底不同膜层开发激光划线等加工设备，并持续关注钙钛矿技术进展及产业化落地。 公司交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无。
日期	2026 年 8 月 19 日